

Electronic Journal 第1485回 Technical Seminar

タッチパネル貼り合わせ技術・部材・装置 徹底解説**～ 打ち抜きから貼り付け・貼り合わせの極意を詳解～**

主催：電子ジャーナル

日時：11月27日（火）13:00～16:20

講師：(株)FUK 開発部 設計課 佐伯和幸氏

会場：連合会館（旧総評会館）

参加費：39,800円（テキスト代/喫茶代/消費税含む）

定員：40名 定員になり次第、締め切らせて頂きます。お早めにお申込み下さい。

タッチパネルを搭載したデバイスの拡大に伴い、これまでのスマートフォンやタブレット用途に留まらず、中型サイズのノートPCや大型サイズのモニタなどの貼り合わせ案件が増加しています。FUKでは、そのようなユーザーの要望に応じて、これまでにOCA（Optical Clear Adhesive Tape/光学透明粘着テープ）を使用したフィルム貼り付け装置、ガラス貼り合わせ装置、OCR（Optical Clear Adhesive Resin / UV硬化樹脂）を使用したガラス貼り合わせ装置を販売しています。デバイスの大型化や薄型化のアプリケーションが増えている昨今、接合材料やプロセス技術のみならず、デバイスの構造も最適化されていないと歩留りの向上は難しいものになっています。本セミナーでは、LCDや有機EL（OLED）の貼り合わせにおける課題点を中心にFUKの取り組みを分かりやすく、かつ詳細に解説します。

《プログラム》

- 【13:00～14:00】 タッチパネル製造工程
打ち抜きに求められるもの
- 【14:00～14:40】 打ち抜きプロセス
貼り付け・貼り合わせに求められるもの
1. 接合材料（OCA・OCR）への要求
2. 部材（ガラス・フィルム）への要求
3. プロセス（装置）への要求
- 【14:50～16:10】 貼り付け・貼り合わせプロセス
1. Soft to Soft/Soft to Hard
2. Hard to Hard
装置の紹介
その他のディスプレイ
貼り付け・貼り合わせの技術トレンド
- 【16:10～16:20】 名刺交換会